



台灣應用材料股份有限公司 函

地址：300 新竹科學園區研發二路 32 號

聯絡人：資深公關經理 譚鳳珠 電話：03-579-3958

pearl\_tan@amat.com

聯太公關 黃悅君 電話：02-2725-3199 分機 827

nicole.huang@unistyle.com.tw

聯太公關 鄭嘉嘉 電話：02-2725-3199 分機 817

tasha.cheng@unistyle.com.tw

10151

臺北市徐州路五號 11 樓

受文者：教育部中等教育司

發文日期：中華民國 101 年 3 月 21 日

發文字號：PR-12-0051

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：隨文

主旨：為協助優秀、弱勢的高中學子，本公司擬舉辦第九屆「創新科技種子營」校園公益活動，請行文轉知所屬機關學校協助宣傳。

說明：

1. 應用材料公司擬自 101 年 3 月 19 日（一）起，與竹塹文教基金會以及台灣兒童暨家庭扶助基金會合作舉辦第九屆「創新科技種子營」校園公益活動，提供弱勢優秀高中學子免費營隊課程，學習趣味無限的團隊與創意競賽，以及至美國矽谷參訪的機會，藉以拓展國內青年學子國際視野，厚植科技基礎實力。
2. 敬請 貴單位行文轉知所屬機關學校協助張貼活動海報以及於校內網站刊登訊息，以嘉惠學子。
3. 檢陳第九屆「創新科技種子營」活動辦法乙份、報名表乙份以及活動海報乙張。

正本：教育部中等教育司

應用材料股份有限公司

## 2012 應用材料第九屆「創新科技種子營」

蘋果賈柏斯說：「創新是決定成為領導者或是跟隨著的關鍵。」身為新世代的你，自認為可以 hold 得住這波科技新浪潮嗎？第九屆「創新科技種子營」現正熱血招募中，邀你與應用材料共同探索科技改善社會問題的無限可能。

即日起至 2012 年 5 月 4 日止，歡迎全國公/私立高中/職生報名，通過徵選者，將免費參加四天三夜「創新科技種子營」，結業者並可獲得新台幣五千元獎學金；還有機會免費深度參訪美國矽谷一週，絕對啟動你對科技與創新的潛力與熱情。

### ➤ 報名資格

全國公/私立高中/職之在學學生，歡迎教師先進們推薦優秀學子報名（曾經參與過本活動營隊者不建議再度報名）。

### ➤ 報名期間

即日起至 2012 年 5 月 4 日（含）止（以郵戳及 e-mail 寄出時間為憑）。

### ➤ 報名方式

於活動期間內至活動網站 <http://www.amtcharity.com/>，下載活動報名表，完整填寫報名表項目（個人資料、自傳、心得報告等）後，連同學生證影本與學期成績單影本乙份等其他相關資料寄至 [campus@unistyle.com.tw](mailto:campus@unistyle.com.tw) 或以掛號方式郵寄至 110 台北市信義區信義路五段 150 巷 2 號 21 樓之 4「創新科技種子營」專案小組收，並請於寄出後電洽 02-2725-3199 轉分機 827 或 817 確認。

※凡於 4 月 13 日（含）前報名的前 100 名早鳥，可獲贈價值新台幣 500 元之圖書禮券。

### ➤ 徵選方式與獎勵

本活動分三階段評選與獎勵：初選、複選（創新科技種子營）、美國矽谷參訪。

#### 初選：

- 依據報名表中的自傳、心得報告以及相關文件資料進行篩選。
- 可依下列三項擇一撰寫心得報告(800-1000 字)：
  - \* 參觀國立台灣科學教育館
  - \* 參觀國立自然科學博物館
  - \* 讀完附件「半導體知識大公開」文章後，撰寫心得感想
- 心得報告須包含以下幾點：
  - \* 簡述在閱讀文章或參觀半導體相關展覽之後，令你印象最深刻的部

分以及原因。

- \* 你認為半導體解決了甚麼問題？製造了甚麼問題？
- \* 你未來是否有投入理工科系的興趣？為什麼？請說明原因。

- 將評選出 50 位學員參加四天三夜的暑期種子營活動，全程參與者將可獲得獎學金新台幣 5,000 元。

**複選：**

- 「創新科技種子營」預計於 2012 年 7 月 4 日至 7 日於台北科學教育館與新竹煙波飯店舉辦，共四天三夜。
- 將於「創新科技種子營」中選出兩組優秀團隊頒發團體獎，每組可獲得價值新台幣 25,000 元之圖書禮券；另外，營隊期間，表現特殊的學員，每位將可再獲得價值新台幣 1,000 至 2,000 元之圖書禮券。
- 結訓完成可獲頒結業證書乙份。

**美國矽谷之旅：**

- 於「創新科技種子營」四天三夜營隊活動中，成績排名前 10 名者可獲選至美國矽谷免費深度參訪一週，參訪時間為 2012 年暑假期間。

➤ **入選公佈**

六月中旬於活動網站 <http://www.amtcharity.com/> 上公佈初選成果

- **共同主辦單位：**台灣應用材料公司·竹塹文教基金會·台灣兒童暨家庭扶助基金會·新加坡商應用材料(股)公司台灣分公司

應用材料為全球最大的晶圓製造、顯示器及太陽能設備供應商，在台深耕多年，致力於關懷台灣社會本土，公益腳步遍及教育研究、慈善捐助、藝術文化以及環保領域。自 2004 年起「創新科技種子營」深入校園，致力於擴大青年學子的國際觀，持續將科技教育的力量向下扎根。

若有任何活動相關的問題，請洽活動專線：02-2725-3199 分機 827 或 817

## 2012 年應用材料第九屆「創新科技種子營」

### 報名表

中文姓名		性別		出生年月日	西元	年	月	日
英文名 (如有)		身分證字號						
就讀學校		科系與年級						
通訊地址	( )							
聯絡電話	(H)	-	e-mail					
	(M)	-						
獎學金 獲獎紀錄	1. _____ 2. _____ 3. _____ (請填寫最近三次的獎學金獲獎紀錄，無則免填)							
學生證影本	(正面)							

(反面)

學期平均成績

(請檢附成績單影本)

全民英檢成績 (若有)

(請檢附成績單影本)

是否有出國經驗?

 是  否

自 傳

可依下列三項擇一題目撰寫心得報告(800-1000字)：

1. 國立台灣科學教育館的「半導體奇e館」參觀心得
2. 國立自然科學博物館「半導體的世界」參觀心得
3. 閱讀附件一「半導體知識大公開」文章

心得報告須包含以下幾點：

1. 簡述在閱讀文章或參觀半導體相關展覽之後，令你印象最深刻的部分以及原因。
2. 你認為半導體解決了甚麼問題？製造了甚麼問題？
3. 你未來是否有投入理工科系的興趣？為什麼？請說明原因。

心得報告

**注意事項**

1. 本報名表請以繕打文字繳交。
2. 繳件時需附此報名表乙份、學生證影本乙份、學期成績單影本，若有全民英檢總成績、參與社會服務之證明文件、家庭清寒證明或獎學金獲獎經驗者，也請附上相關證明。
3. 完整填寫報名表項目(個人資料、自傳、心得報告等)後，連同學生證影本與學期成績單影本乙份等其他相關資料寄至 campus@unistyle.com.tw 或以掛號方式郵寄至 110 台北市信義區信義路五段 150 巷 2 號 21 樓之 4「創新科技種子營」專案小組收，並請於寄出後電洽 02-2725-3199 轉分機 827 或 817 確認。
4. 報名期間從即日起至 2012 年 5 月 4 日(含)止(以郵戳及 e-mail 寄出時間為憑，逾期視同放棄參賽資格)。※凡於 4 月 13 日(含)前報名的前 100 名早鳥，可獲贈價值新台幣 500 元之圖書禮券。